



⑳1 Aktenzeichen: P 43 16 003.4
⑳2 Anmeldetag: 13. 5. 93
⑳3 Offenlegungstag: 17. 11. 94

⑦1 Anmelder:
Forschungszentrum Rossendorf eV, 01474
Rossendorf, DE

⑦2 Erfinder:
Howitz, Steffen, Dr., 0-8019 Dresden, DE; Pham,
Minh Tan, Dr., 0-8051 Dresden, DE

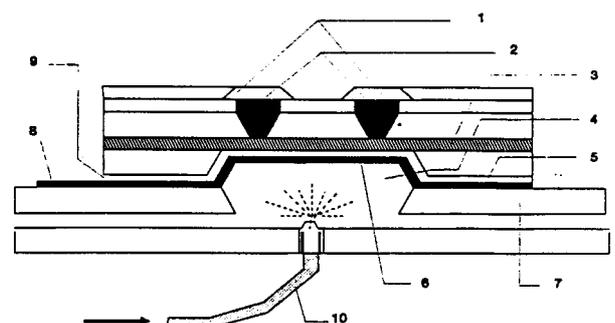
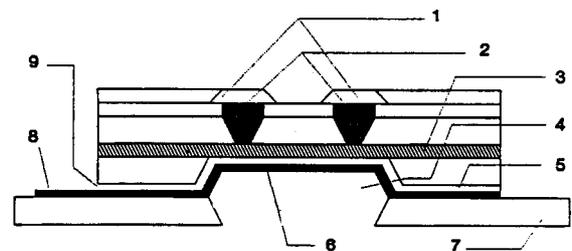
⑤6 Für die Beurteilung der Patentfähigkeit
in Betracht zu ziehende Druckschriften:
JP 55-27954 A., In: Patents Abstracts of Japan, P-9,
April 30, 1980, Vol.4, No.58;

⑤4 Redundanz-ISFET

⑦2 Die Erfindung betrifft einen Redundanz-ISFET vorzugsweise für den Einsatz in FLUIDIK-ISFET-Meßsystemen. Insbesondere betrifft die vorliegende Erfindung Mittel zur Passivierung und Aktivierung der ISFET-Funktion, welche es ermöglichen, aus einem Array einzelne ISFETs seriell nach Bedarf in den Meßzyklus einzuschalten und dadurch dem Meßsystem eine problemangepaßte Lebensdauer zu verleihen.

Erfindungsgemäß erhält ein Redundanz-ISFET zusätzlich zur chemisch sensitiven Gate-Membran (5) eine gateabdeckende Opferschicht (6), welche einen direkten Kontakt der chemisch sensitiven Membran mit dem Meßmedium unterbindet und damit den Alterungsprozeß des ISFETs verhindert.

Die Opferschicht besteht z. B. aus Metall (Al, Cr, Ni, Au) oder aus photosensitivem Polymer. Die Aktivierung der ISFET-Funktion erfolgt durch gezielte Entfernung der Opferschicht durch elektrochemische oder optochemische Auflösung. Ein Array von derartigen Redundanz-ISFETs gestattet es, einem kontinuierlichen Fluidik-Meßsystemen eine frei wählbare Lebensdauer zu verleihen.



Die vorliegende Erfindung betrifft einen Redundanz-ISFET vorzugsweise für den Einsatz in FLUIDIK-ISFET-Meßsystemen. Insbesondere betrifft die vorliegende Erfindung Mittel zur Passivierung und Aktivierung der ISFET-Funktion, welches es ermöglichen, aus einem Array einzelne ISFETs seriell nach Bedarf in den Meßzyklus einzuschalten und dadurch dem Meßsystem eine problemangepaßte Lebensdauer zu verleihen.

Insbesondere durch den Einsatz in komplexen, eine Vielzahl von ISFETs aufweisenden chemischen Meßsystemen ist das die Lebensdauer des Gesamtsystems bestimmende Problem der Lebensdauer der Einzelkomponenten bedeutsam geworden. Diese wiederum wird im wesentlichen durch die Membrandegradation im meßmedialen Kontakt, besonders beim kontinuierlichen und langzeitigen Einsatz der ISFETs bestimmt.

In bisherigen Lösungsansätzen wurde versucht, Werkstoffsysteme für chemisch empfindliche Membranen zu entwickeln, mit denen das Alterungsverhalten im Sinne einer Lebensdauerverbesserung begünstigt wurde. Erreicht wurden damit jedoch nur Lebensdauerverbesserungen um Tage und Wochen (<Sensors and Actuators B, 4 (1991) 53-63) was in etwa eine Verdoppelung der schichtabhängigen durchschnittlichen Lebensdauer der ISFETs entspricht.

Aufgabe der Erfindung ist es, die Lebensdauer von ISFET-Meßsystemen zu erhöhen. Erfindungsgemäß geschieht dies durch Einführung der in den Patentansprüchen beschriebenen Redundanz-ISFETs, die zunächst inaktiv sind und in dieser Wartezeit nicht altern können, weil deren chemisch empfindliche Membran vom Meßgut nicht benetzt wird. Erst durch gezielte Aktivierung der Redundanz-ISFETs durch serielle Entfernung der Opferschicht, wird der Redundanz-ISFET in den Meßzyklus übernommen.

Mit der Erfindung ist es möglich, eine zeitlich reproduzierbare und auf eindeutig nur eine Opferschicht adressierbare Schaltfunktion zur Entfernung der Opferschicht zu geben. Als Resultat der Opferschichtentfernung am avisierten Redundanz-ISFET gelangt dessen chemisch aktive Membranoberfläche, die hinsichtlich ihrer chemischen Sensitivität und Selektivität zur Ausübung der Meßfunktion innerhalb des Sensorarrays ausgelegt ist, in meßmedialen Kontakt. Die o.g. Schaltfunktion zur Opferschichtentfernung kann als Softwareelement in die Systemsoftware des elektrochemischen Meßsystems derart eingebunden werden, daß sie in Abhängigkeit vom Alterungsverhalten der bisher aktiven ISFETs ausgelöst wird. Damit ist eine im wesentlichen von der Anzahl der im Meßsystem angeordneten Redundanz-ISFETs abhängige deutliche Lebensdauerverlängerung kompletter Meßsysteme möglich.

Die Erfindung wird nachfolgend an Ausführungsbeispielen näher erläutert. Die zugehörige Zeichnung zeigt einen Querschnitt durch einen passiven Redundanz-ISFET, der in ein Fluidik-ISFET-Meßsystem eingebunden ist

Der Redundanz-ISFET basiert auf einem an sich bekannten Rückseitenmembran-ISFET, bestehend aus der Drain-Source-Metallisierung (1), den Drain-Source-Gebieten (2), dem vergrabenen SIMOX-Isolator (3), dem freigelegten RSM-Gebiet (Rückseitenmembran) im Kontakt zum Fluid (4), der ISFET-Membranschicht (5), der Opferschicht (6) und dem Träger-Si (7). Die Opferschicht (6) besteht beispielsweise aus einer elektrochemisch auflösbaren und zwischen 500 nm und 800 nm dik-

ken Metallisierungsschicht, die neben der Funktion der Membranpassivierung auch montagetechnologische Bedeutung hat Sie übernimmt neben der Aufgabe der Membranabdeckung als Opferschicht im Bereich (9) außerhalb dieser Membran die Funktion der Übergangsbzw. Koppelschicht zwischen Sensorelement und Durchflußzelle. Für die Aufgabe der Opferschicht wird in diesem Beispiel eine geschlossene Doppelschicht aus Cr (300 nm) und Au (200 nm) eingesetzt, die elektrisch leitend ist und von der Steuerelektronik des Meßsystems über den Kontakt (8) ein spezifisches Auflösungspotential gegen das in der Durchflußzelle strömende elektrolytische Fluid erhält. In chloridhaltigen oder sulphathaltigen Elektrolytlösungen im pH-Bereich von 2... 10 wird zur Entfernung der Opferschicht und zur Reaktivierung der ISFET-Funktion folgendes Arbeitsregime verwendet: Potential der Opferschicht 4 V gegen Meßmedium, Stromdichte 4... 5 A/dm², Dauer der Aktivierung 4... 6 min. Das strömende Fluid hat einerseits die elektrische Funktion, ein Auflösungspotential für genau eine Opferschicht bereitzustellen, andererseits transportiert es das in Lösung gehende Opferschichtmetall aus der Zelle. Für die Aufgabe als Übergangsbzw. Koppelschicht muß die Opferschicht entweder lötfähig (Gold oder Chrom) oder klebefähig (Chrom, Gold, Nickel) sein. Der nach der Redundanz-ISFET-Aktivierung stehenbleibende Rest der Opferschicht hat nur noch die mechanische Funktion einer hermetisch dichten Verbindungszone.

In einem weiteren, in Fig. 2 dargestellten Ausführungsbeispiel wird als Membranabdeckungsschicht das fotosensitive Polymermaterial Micro posit 1300-27 (Shipley) eingesetzt. Durch Auftragen und Schleudern wird das Material in einer Schichtdicke von ca. 1...3 µm auf das zu schützende Gate-Gebiet des ISFETs aufgebracht und bei 80 °C für 2 Stunden getempert. Aus Testmessungen geht hervor, daß eine derartige Opferschicht für Meßmedien im pH-Bereich von 4... 8 eine wirksame Barriere gegen Alterungsprozesse der ISFET-Membran darstellt. Zum Initiieren der gezielten Entfernung der Opferschicht wird das betreffende Gebiet über den Lichtleiter (10) mit Licht im Spektralbereich von 460... 480 nm bei einer Energiedichte von 15 mW/cm² für 30 s lokal belichtet. Der Lösungsprozeß erfolgt anschließend mit einer Glycerin-Wassergemisch in 4%iger Trinatriumphosphatlösung welche kurzzeitig anstelle des Meßfluids eingesetzt wird.

Patentansprüche

1. Redundanz-ISFET, vorzugsweise für den Einsatz in Fluidik-ISFET-Meßsystemen, **dadurch gekennzeichnet**, daß der chemisch empfindliche Gate-Isolator durch eine zusätzliche, gegenüber dem Meßmedium resistente, selektiv entfernbar, den Kontakt der Membran mit dem Meßmedium verhin- dernde Opferschicht überzogen ist, und daß der ISFET Mittel aufweist, die eine von außen gesteuerte Entfernung der Opferschicht ermöglichen.
2. Redundanz-ISFET nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Opferschicht ein Metall, ein Polymer oder eine Kombination aus Metall und Polymer ist.
3. Redundanz-ISFET nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Mittel zur Entfernung der Opferschicht elektrochemischer oder optochemischer Natur sind.
4. Redundanz-ISFET nach Anspruch 1, dadurch ge-

kennzeichnet, daß die den Gate-Isolator bedeckende Opferschicht flächenmäßig über den chemisch empfindlichen Bereich hinausreicht und dort als Übergangs- bzw. Koppelschicht zwischen Sensorelement und Durchflußzelle eingesetzt ist.

5

Hierzu 1 Seite(n) Zeichnungen

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

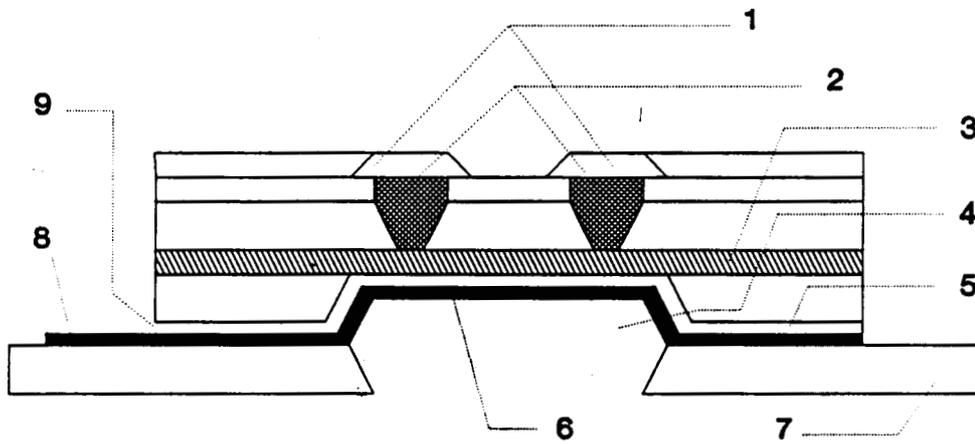


Fig. 1

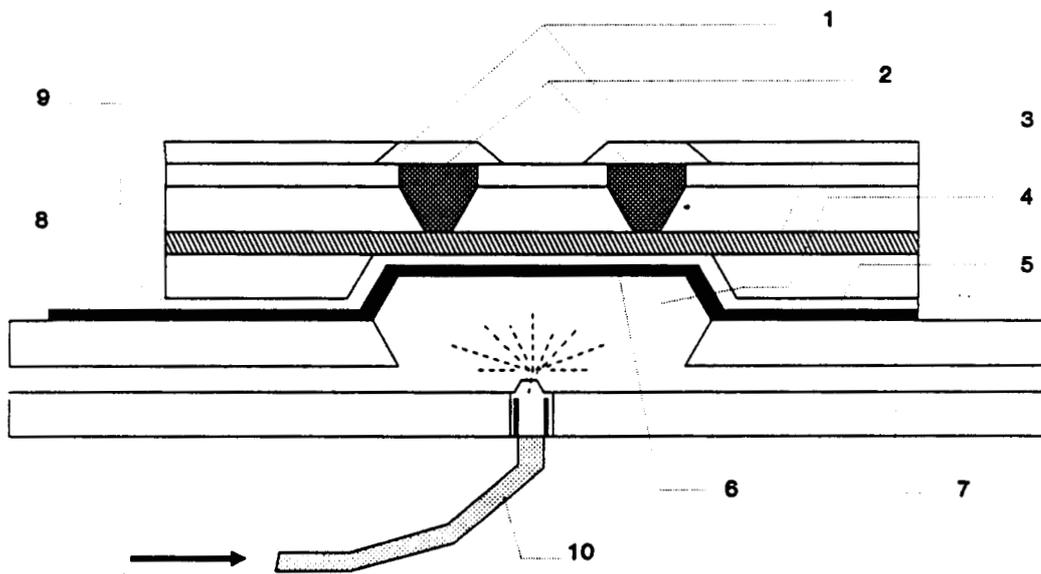


Fig. 2